



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	带散热功能的三维堆叠芯片的制造方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201410086565.6
申请日期:	2014-03-10
专利号:	201410086565.6
第一发明人:	王启东;邱德龙;武晓萌;曹立强;于大全;谢慧琴;张迪
实施情况:	授权
专利证书号:	201410086565.6
其它备注:	封装中心

